

Auftragsarten:

1O	=	1- seitige Leiterplatte, o hne bohren
1M	=	1- seitige Leiterplatte, m anuelles bohren
1A	=	1- seitige Leiterplatte, a utomatisch bohren
2O	=	2- seitige Leiterplatte, o hne Bohren
2M	=	2- seitige Leiterplatte, m anuelles bohren
2A	=	2- seitige Leiterplatte, a utomatisches bohren

Arbeitsschritte EINSEITIG:

1O + 1M:

- 1) Basismaterial EINSEITIG um max. 5mm umlaufend größer (als die Platine) zuschneiden
- 2) Basismaterial in den Belichter legen
- 3) Filmvorlage so auf die Platine legen, sodass die Schrift LESERICHTIG positioniert wird (Film nicht festkleben) und belichten
- 4) Platine entwickeln (auf die Lesbarkeit der Schrift achten)
- 5) Platine ätzen usw....

1A:

- 1) Basismaterial EINSEITIG um 5mm umlaufend größer (als die Platine ist) zuschneiden
- 2) Platine mit IS700 automatisch bohren (**alle Bohrungen**)
- 3) Film über Leuchtpult auf gebohrter Platine positionieren (ACHTUNG: Lochbild muss mit Pads überein stimmen und die Schrift im Layout muss nun lesbar sein) und mit Uhu-Stick die Folie nun auf einer Langseite (außerhalb der Platine) festkleben und belichten
- 4) Platine entwickeln (auf die Lesbarkeit der Schrift achten)
- 5) Platine ätzen usw....

Arbeitsschritte DOPPELSEITIG:

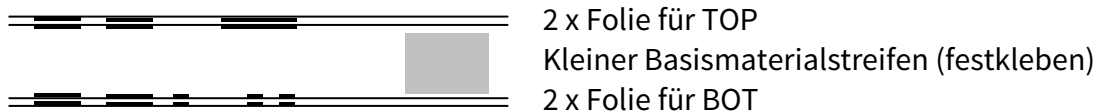
20 + 2M:

- 1) Basismaterial DOPPELSEITIG um max. 5mm umlaufend größer (als die Platine) zuschneiden
- 2) Filmtasche kleben (auf Lesbarkeit der Schrift achten)
- 3) Platine in die Filmtasche legen und beidseitig belichten

2A:

- 1) Basismaterial DOPPELSEITIG um 5mm umlaufend größer (als die Platine) zuschneiden
- 2) Platine mit IS700 automatisch bohren (**nur den ersten Bohrdurchmesser = Passmarkenbohrungen**)
- 3) Film über Leuchtpult auf gebohrter Platine positionieren und optimal auf Bohrungen einpassen (ACHTUNG: die Schrift im Layout muss nun lesbar sein). Mit Uhu-Stick die Folie nun auf einer Langseite (außerhalb der Platine) festkleben
- 4) Platine im doppelseitigem Belichter belichten
- 5) Platine entwickeln (Schrift auf Lesbarkeit überprüfen)
- 6) Platine ätzen
- 7) Schutzlack stripfen (10min)
- 8) Alle weiteren Bohrdurchmesser auf der IS700 bohren
- 9) Endzuschnitt
- 10) Oberfläche abschleifen
- 11) Lötack SK10 aufbringen (15min trocknen lassen)

Filmtasche:



Platine mit Filmtasche belichten:

